

# マイクロモジュールテクノロジー株式会社



設計・製作・製品

金型・治工具

機械要素・部品

工業用装置機器等

ロボット・ドローン

次世代交通システム

電気・電子機器等

通信・監視・計測・分析等

主要業務が設計・開発（ファブレス的）

自動車・鉄道・船舶

家電・エレクトロニクス

航空・宇宙・海洋

環境・エネルギー



半導体組立や各種半導体モジュールを、開発から試作・中規模量産までフレキシブルにワンストップ提供している技術開発型メーカーです。

## 得意技術

半導体ベアチップ実装技術をコアにファイン接合技術、各種センサパッケージング技術、次世代パワーモジュールの小型化技術などを保有。

- ・半導体ベアチップのバンブ形成、フリップチップ実装、ワイヤボンディング、特殊モールド技術
- ・CMOS センサ、MEMS センサ、磁気センサ等のパッケージング技術
- ・SiC デバイス 等の次世代パワーモジュール技術
- ・小型カメラモジュール技術

## 主要事業・主要製品

主要事業：各種半導体モジュールの開発・試作・量産製造

主要製品

- ・半導体実装（組立）及び高密度表面実装の受託製造
- ・各種小型センサパッケージ（カメラモジュール、CMOS センサ、分光センサ、MEMS センサ等）
- ・各種パワーモジュール（小型 SiC パワーモジュール、両面放熱型パワーカード等）
- ・光通信モジュール、高輝度LED モジュール、高周波モジュール、RFID モジュール 等

## 得意な顧客・市場分野

得意な顧客：電機メーカー、電子部品メーカー、半導体メーカー、材料メーカー、大学、研究機関

市場分野：エレクトロニクス分野（カメラモジュール、センサPKG、各種半導体モジュール）

- ・車載機器分野（カメラ、パワーモジュール）、環境・エネルギー分野（電力変換モジュール）
- ・医療機器分野（センサモジュール）

## 今後の展開について

次世代半導体実装技術、光学実装技術を開発し、センサ・カメラモジュール事業及びパワーモジュール事業の拡大

## SDGs 取組

エコアクション 21（環境省）の取組と合わせ、廃棄物の削減、CO2削減等の取組を積極的に行っています。



## グローバルビジネス

- ・センサ・カメラモジュールを中心に海外販売展開
- ・中長期的には現地生産も視野に入れ、海外部品材料の調達、海外生産を検討



## 公的助成事業 受託

- 平成 23 年度 グリーン IT 活用産業振興事業
- 平成 24 年度 ものづくり中小企業・小規模事業所試作開発等支援補助金
- 平成 25 年度 エネルギー関連ベンチャー事業化促進事業
- 平成 25 年度 かながわ成長産業イノベーション事業
- 平成 26 年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
- 平成 26 年度 エネルギー関連等ベンチャー事業化促進事業
- 平成 26 年度 横浜市中企業新技術・新製品開発促進助成金
- 平成 30 年度 横浜市中企業新技術・新製品開発促進助成金
- 令和 2 年度 戦略的基盤技術高度化支援事業

## 取得資格・認証 (ISO 等)

- ・ISO9001：2015 年度版（平成 26 年～）
- ・横浜知財みらい企業（平成 24 年～）
- ・エコアクション 21（平成 30 年～）

## 主要設備・研究体制

- ・主要設備：フリップチップボンダ、ダイボンダ、ワイヤボンダ、トランスファモールド装置、真空ギ酸リフロー装置、プラズマドライ洗浄装置、BGA ボールマウンター、SMT 実装ライン、2D&3D プレス装置、超音波探傷解析装置、X線透過装置、FE-SEM、レーザー顕微鏡、パワーメーター等、クリーンルームクラス 100～1000 等
- ・研究体制：神奈川県立産業技術総合研究所、横浜国立大学 等研究機関の協力を得て先端技術の開発取組を実施しています。

## 主要取引先

アドバンテスト、ソニーセミコンダクタソリューションズ、リコー、ニコン、富士フイルムビジネスイノベーション、日立製作所、パナソニック、産業技術総合研究所、東京大学、東京工業大学 等

## 取引先金融機関

横浜銀行、みずほ銀行、横浜信用金庫、日本政策金融公庫

名称	マイクロモジュールテクノロジーカブシキガイシャ マイクロモジュールテクノロジー株式会社	代表者	原園 文一	担当窓口	香西 直美	資本金	1,200 万円	従業員数	20 名
所在地	〒 230-0045 横浜市鶴見区末広町 1-1-40			TEL	045-510-3080	FAX	045-510-3081		
HP	<a href="http://www.micro-module.co.jp">http://www.micro-module.co.jp</a>			E-mail	mm-tech@micro-module.co.jp				